

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当社グループ（当社及び連結子会社）では、1,676億円（前連結会計年度比32.7%減）の設備投資を行いました。

テクノロジーソリューションでは、国内での主要な事業所のひとつである富士通ソリューションスクエアの土地及び建物の所有権を取得したほか、英国におけるアウトソーシング商談拡大に向けた設備及び国内データセンターの設備の拡充を行い、877億円を投資いたしました。

ユビキタスプロダクトソリューションでは、パソコン、携帯電話の新機種対応に向けた設備投資のほか、HDDの垂直磁気記録方式用設備などで、187億円を投資いたしました。

デバイスソリューションでは、先端ロジックLSI関連で、富士通マイクロエレクトロニクス株式会社三重工場300mm第2棟への投資及び基盤ロジックLSIの設備の更新投資を行ったほか、電子部品関連の設備を含め、396億円を投資いたしました。

なお、設備投資額につきましては、上記セグメント以外に215億円が含まれております。

当社グループは、デバイスソリューションのLSI事業に関し、今後の利用計画を見直した富士通マイクロエレクトロニクス株式会社三重工場300mm第2棟に係る資産について、499億円の減損損失を計上いたしました。また、ユビキタスプロダクトソリューションにおいて、事業譲渡を決定したHDD事業に係る資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額（162億円）を事業構造改善費用に含めて特別損失に計上いたしました。詳細については、「第5 経理の状況 1. 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項（連結損益計算書関係）」に記載しております。

2【主要な設備の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、以下のとおりです。

(1) テクノロジーソリューション

平成21年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本（百万円）					従業員数 (人)	
		建物 及び 構築物	機械 及び 装置	工具、 器具及び 備品	土地 (面積千㎡)	合計		
提出 会社	富士通ソリューション スクエア (東京都大田区)	システム開発 設備	15,195	137	1,517	11,971 (24)	28,822	4,003
	幕張システムラボラトリ (千葉県美浜区)	システム開発 設備	9,256	10	703	3,708 (14)	13,678	730
	館林システムセンター (群馬県館林市)	アウトソーシ ング設備	6,522	155	5,571	1,913 (126)	14,163	137
	小山工場 (栃木県小山市)	光伝送システ ム製造設備	3,666	162	523	299 (167)	4,652	552
	那須工場 (栃木県大田原市)	移動通信システ ム製造設備	2,411	357	1,903	1,250 (184)	5,922	478
国内子 会社	富士通エフ・アイ・ピー株式 会社 横浜センタ (横浜市都筑区) (注) 3.	アウトソーシ ング設備	4,702	—	4,078	— (—)	8,780	67
	富士通エフ・アイ・ピー株式 会社 東京センタ (川崎市中原区) (注) 3.	アウトソーシ ング設備	1,425	—	3,688	— (—)	5,114	392
	富士通フロンテック株式会社 新潟工場 (新潟県燕市)	金融・自動機 関連機器製造 設備	1,847	313	883	1,611 (47)	4,655	509
	株式会社富士通ITプロダク ツ 本社工場 (石川県かほく市)	コンピュータ 製造設備	1,913	475	454	388 (129)	3,232	512

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本 (百万円)					従業員数 (人)	
		建物 及び 構築物	機械 及び 装置	工具、 器具及び 備品	土地 (面積千㎡)	合計		
在外子 会社	Fujitsu Services Holdings PLC (イギリス他) (注) 4.	システム開発 設備及びアウ トソーシング 設備	16,332	2,192	23,260	— (—)	41,784	21,060
	Fujitsu Network Communications, Inc. リチャードソン工場 (米国テキサス州)	光伝送システ ム製造設備	3,853	797	2,747	2,294 (539)	9,691	1,321

(2) ユビキタスプロダクトソリューション

平成21年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本 (百万円)					従業員数 (人)	
		建物 及び 構築物	機械 及び 装置	工具、 器具及び 備品	土地 (面積千㎡)	合計		
提出 会社	長野工場 (長野県長野市)	HDD製造 設備	2,766	18	90	805 (103)	3,680	362
国内子 会社	株式会社島根富士通 本社工場 (島根県簸川郡斐川町) (注) 5.	パソコン製造 設備	1,779	879	82	— (110)	2,741	575
	富士通アインテック株式会社 本社工場 (福島県伊達市)	パソコン製造 設備	1,249	246	276	591 (73)	2,364	769
	富士通モバイルフォンプロダ クツ株式会社 本社工場 (栃木県大田原市) (注) 6.	携帯電話製造 設備	99	1,750	196	— (—)	2,047	225
在外子 会社	Fujitsu Computer Products Corporation of the Philippines カーメルレイ工場 (フィリピン) (注) 7.	HDD製造 設備	1,526	2,347	136	— (283)	4,009	2,813
	Fujitsu (Thailand) Co., Ltd. 本社工場 (タイ)	HDD製造 設備	3,570	5,315	984	523 (114)	10,392	3,932

(3) デバイスソリューション

平成21年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本 (百万円)					従業員数 (人)
		建物 及び 構築物	機械 及び 装置	工具、 器具及び 備品	土地 (面積千㎡)	合計	
富士通マイクロエレクトロ ニクス株式会社 三重工場 (三重県桑名市) (注) 8.	半導体 製造設備	37,418	34,225	3,786	4,327 (307)	79,758	1,545
富士通マイクロエレクトロ ニクス株式会社 岩手工場 (岩手県胆沢郡金ヶ崎町)	半導体 製造設備	5,554	4,282	1,180	2,881 (290)	13,898	1,617
富士通マイクロエレクトロ ニクス株式会社 会津若松工 場 (福島県会津若松市)	半導体 製造設備	2,473	1,753	508	3,146 (259)	7,882	1,342
富士通セミコンダクターテ クノロジー株式会社 本社工場 (福島県会津若松市) (注) 9.	半導体 製造設備	8,169	799	56	— (62)	9,025	537
新光電気工業株式会社 高丘工場 (長野県中野市)	リードフレー ム等製造設備	4,936	4,396	901	2,109 (94)	12,343	932
新光電気工業株式会社 若穂工場 (長野県長野市)	P L P 製造 設備	5,014	6,161	113	349 (17)	11,639	440
新光電気工業株式会社 新井工場 (新潟県妙高市)	リードフレー ム等製造設備	3,682	5,172	475	1,149 (122)	10,479	1,011
新光電気工業株式会社 更北工場 (長野県長野市)	P L P 等製造 設備	3,231	7,477	829	615 (45)	12,154	1,197

(4) その他

平成21年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本 (百万円)					従業員数 (人)
		建物 及び 構築物	機械 及び 装置	工具、 器具及び 備品	土地 (面積千㎡)	合計	
富士通テン株式会社 神戸工場 (兵庫県神戸市) (注) 10.	車載機器の開 発・製造設備	4,144	896	2,927	1,638 (43)	9,606	2,806

(5) 共通

平成21年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)		設備の内容	投下資本(百万円)					従業員数 (人)
			建物 及び 構築物	機械 及び 装置	工具、 器具及び 備品	土地 (面積千㎡)	合計	
提出 会社	川崎工場 (川崎市中原区)	ソフトウェア、情報システム及び通信システムに関する研究開発設備	12,908	225	6,789	3,454 (164)	23,378	9,152
	沼津工場 (静岡県沼津市)	ソフトウェア開発設備	7,764	1,116	6,164	3,737 (549)	18,783	1,035
国内子 会社	株式会社富士通研究所 厚木研究所 (神奈川県厚木市) (注) 5.	ソフトウェア、情報システム、通信システム及び電子デバイスに関する研究開発設備	2,698	1,670	1,261	— (19)	5,630	460

- (注) 1. 投下資本は期末帳簿価額によります。なお、投下資本の合計額には、建設仮勘定は含みません。投下資本の期末帳簿価額にはリース資産の期末帳簿価額を含んでおります。
2. 投下資本の機械及び装置には、車両及び運搬具を含みます。
3. 富士通エフ・アイ・ピー株式会社横浜センタ及び東京センタは、それぞれ建物を賃借しております。また、横浜センタ及び東京センタの投下資本の合計額には、それぞれ1,280百万円、2,343百万円のリース資産を含んでおります。
4. Fujitsu Services Holdings PLCの数值は連結決算数值であります。また、建物の一部を賃借しております。
5. 株式会社島根富士通及び株式会社富士通研究所の土地はすべて当社から賃借しているものです。
6. 富士通モバイルフォンプロダクツ株式会社本社工場は、当社より当社の建物の一部を賃借しております。
7. Fujitsu Computer Products Corporation of the Philippinesの土地はすべてFujitsu Development Corporation of the Philippinesから賃借しているものです。
8. 富士通マイクロエレクトロニクス株式会社三重工場の投下資本の合計額には、25,581百万円のリース資産を含んでおります。
9. 富士通セミコンダクターテクノロジー株式会社の土地はすべて富士通マイクロエレクトロニクス株式会社より賃借しているものです。
10. 富士通テン株式会社神戸工場の投下資本の合計額には、1,448百万円のリース資産を含んでおります。

3 【設備の新設、除却等の計画】

当社グループ（当社及び連結子会社）の当連結会計年度後1年間の設備投資計画（新設・拡充）は1,600億円であり、事業の種類別セグメントごとの内訳は次のとおりであります。なお、重要な施設の新設、拡充、改修の計画はありません。

事業の種類別セグメントの名称	平成21年3月末計画額 (億円)	設備等の主な内容・目的
テクノロジーソリューション	1,000	国内データセンター設備及び英国におけるアウトソーシング設備
ユビキタスプロダクトソリューション	100	パソコン製造設備及び携帯電話製造設備
デバイスソリューション	350	L S I 製造設備
その他、全社（共通）	150	オーディオ・ナビゲーション機器、移動通信機器及び自動車用電子機器の開発・製造設備
計	1,600	

- (注) 1. 所要資金1,600億円は、主として自己資金により充当する予定です。
2. 設備投資の計画額は、消費税抜きで表示しております。
3. 経常的な設備の更新のための除・売却を除き、重要な設備の除・売却の計画はありません。
4. 全社（共通）は、一般管理部門及び共通研究費等のセグメントに配賦不能な設備投資額です。